

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-040

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称或“公司”）（含子公司）2025 年拟向全资子公司提供合计不超过人民币 27 亿元财务资助。有效期自股东大会决议通过之日起 1 年内有效，其中：

1、向无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称“无锡伟测”）提供不超过 13 亿元的财务资助额度；

2、向南京伟测半导体科技有限公司（以下简称“南京伟测”）提供不超过 13 亿元的财务资助额度；

3、向深圳伟测半导体科技有限公司（以下简称“深圳伟测”）提供不超过 0.6 亿元的财务资助额度；

4、向天津伟测半导体科技有限公司（以下简称“天津伟测”）提供不超过 0.4 亿元的财务资助额度。

具体资助金额可根据各子公司实际业务进行调整，该额度在有效期内可循环使用。

● 公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了本次财务资助事项，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助概述

（一）财务资助预计情况

1、为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2025年度公司（包含子公司）拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的全资子公司提供合计不超过27亿元的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等），其中，向无锡伟测提供不超过13亿元的财务资助额度；向南京伟测提供不超过13亿元的财务资助额度；向深圳伟测提供不超过0.6亿元的财务资助额度；向天津伟测提供不超过0.4亿元的财务资助额度，上述额度有效期自股东大会决议通过之日起1年内有效，具体资助金额可根据各子公司实际业务进行调整，上述额度在有效期内可循环使用。

2、本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3、本事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）无锡伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2020年6月9日

2、注册地点：无锡市新吴区新加坡工业园新达路28-12号厂房

3、注册资本：43,000万人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有无锡伟测100%的股权

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	234,011.14	206,178.78
负债总额	155,843.86	129,359.11
净资产	78,167.28	76,819.67
	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	17,299.30	67,765.05
净利润	1,087.72	12,085.80

注：以上年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，季度数据未经审计，上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。下同。

（二）南京伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2021年10月21日

2、注册地点：江苏省南京市浦口区云实路19号

3、注册资本：25,000 万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件开发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有南京伟测100%的股权

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	213,366.96	211,482.19
负债总额	179,088.82	178,441.52
净资产	34,278.14	33,040.67

	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	8,822.12	23,000.13
净利润	1,161.81	1,681.11

（三）深圳伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2023年9月6日

2、注册地点：深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦602

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：骈文胜

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有深圳伟测100%的股权

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2025年3月31日 （未经审计）	2024年12月31日 （经审计）
资产总额	2,531.81	2,113.06
负债总额	2,298.85	1,589.05
净资产	232.97	524.00
	2025年1-3月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	379.48	1,586.59
净利润	-313.69	-1,355.32

（四）天津伟测半导体科技有限公司

1、成立日期：2024年6月17日

2、注册地点：天津市西青经济技术开发区业盛道10号E座1-2层

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：郭敬

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片设计及服务；软件销售；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有天津伟测100%的股权

7、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	882.03	974.82
负债总额	161.16	165.55
净资产	720.87	809.27
	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	65.26	15.34
净利润	-99.15	-207.21

三、本次提供财务资助的目的及对公司的影响

本次向全资子公司提供财务资助系公司为了聚焦高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片（车规级、工业级）的测试需求等相关业务拓展的资金需求。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

四、公司履行的审议程序

公司于2025年5月8日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本事项尚需提交

股东大会审议。

五、监事会意见说明

监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日